各 位

会 社 名 白 銅 株 式 会 社 代表者の 役職氏名 代表取締役社長 角 田 浩 司 (コード番号: 7637 東証プライム) 問合せ先 責 任 者 経営管理本部長 關濱 亮 電話番号 03(6212)2811

(訂正)「2023年3月期決算説明資料」の一部訂正について

2023年5月12日に開示いたしました「2023年3月期決算説明資料」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「2023年3月期 決算説明資料」に記載誤りなどがあり、訂正を行うものです。

2. 訂正内容

2023年3月期実績

棚卸資産影響額 訂正前:499百万円 訂正後:505百万円

3. 訂正箇所

4ページ、10ページ、20ページ、23ページ 詳細は別紙をご参照ください。訂正箇所は黄色塗りで示しております。

以上

連結損益計算書(PL)サマリ

- 売上高は過去最高額を記録した前年を11.1%上回り、過去最高額を更新
- 経常利益では、一時費用の計上および各種コストの増加や棚卸資産影響額による差益の減少により、前連結会計年度比△8.8%となった

11/		77	
- HH /	17	\Box	ш
+	1/	百万	'I J

	2022年3月期	売上高 比率	2023年3月期	売上高 比率	増減率
売上高	55,441	-	61,602	-	11.1%
標準在庫品	35,625	64.3%	38,322	62.2%	7.6%
特注品	19,815	35.7%	23,279	37.8%	17.5%
売上総利益	10,309	18.6%	10,152	16.5%	△1.5%
営業利益	4,256	7.7%	3,777	6.1%	△11.2%
経常利益	4,373	7.9%	3,988	6.5%	△8.8%
棚卸資産影響額(△は損)	610	-	499	-	△18.1%
為替差損益(△は損)	20	-	20	-	1.1%
経常利益 (棚卸資産・為替影響を除く)	3,743	6.8%	3,468	5.6%	△7.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,964	5.3%	2,737	4.4%	△7.6%

【訂正後】

連結損益計算書(PL)サマリ

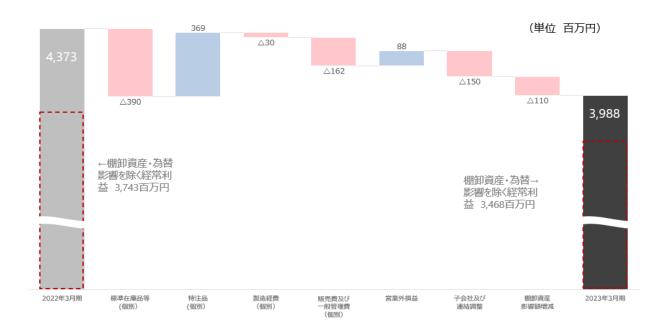
- 売上高は過去最高額を記録した前年を11.1%上回り、過去最高額を更新
- 経常利益では、一時費用の計上および各種コストの増加や棚卸資産影響額による差益の減少により、前連結会計年度比△8.8%となった

単位:百万円

	2022年3月期	売上高 比率	2023年3月期	売上高 比率	増減率
売上高	55,441	-	61,602	-	11.1%
標準在庫品	35,625	64.3%	38,322	62.2%	7.6%
特注品	19,815	35.7%	23,279	37.8%	17.5%
売上総利益	10,309	18.6%	10,152	16.5%	△1.5%
営業利益	4,256	7.7%	3,777	6.1%	△11.2%
経常利益	4,373	7.9%	3,988	6.5%	△8.8%
棚卸資産影響額(△は損)	610	-	<mark>505</mark>	-	<u>△17.2%</u>
為替差損益 (△は損)	20	-	20	-	1.1%
経常利益 (棚卸資産・為替影響を除く)	3,743	6.8%	<mark>3,463</mark>	5.6%	<mark>△7.5%</mark>
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,964	5.3%	2,737	4.4%	△7.6%

経常利益の前連結会計年度比差異要因

• 売上高は過去最高を更新も、運賃や電気料金をはじめとする各種コストの上昇や WCAS社持分取得に関する一時費用などにより△384百万円の減益



【訂正後】

経常利益の前連結会計年度比差異要因

売上高は過去最高を更新も、運賃や電気料金をはじめとする各種コストの上昇やWCAS社持分取得に関する一時費用などにより△384百万円の減益



通期連結業績予想

- 当社グループ業績に影響が大きい半導体製造装置業界で調整局面の継続が予想されており、2024年3月期予想は対前期比で減益の見通し
- 一方で、2024年3月期下半期以降、EV、IoTやDX、AIの推進など半導体需要は回復していてものと予想し、中期経営計画3年目の目標値は達成見込み

(百万円)	2023年3月期 実績	売上高 比率	2024年3月期 通期予想	売上高 比率	対前連結 会計年度 増減率	中期経営計画 2024年3月期 目標値
売上高	61,602	-	63,200	-	2.6%	66,800
営業利益	3,777	6.1%	2,970	4.7%	△21.4%	-
経常利益	3,988	6.5%	3,180	5.0%	△20.3%	4,500
棚卸資産影響額 (△は損)	499	-	0	-	-	-
経常利益 (棚卸資産・為替 影響を除く)	3,468	5.6%	3,180	5.0%	△20.3%	-
親会社に帰属する 当期純利益	2,737	4.4%	2,150	3.4%	△21.5%	-

中期経営計画 2025年3月期 目標値
71,800
5,400

【訂正後】

通期連結業績予想

- 当社グループ業績に影響が大きい半導体製造装置業界で調整局面の継続が予想されており、2024年3月期予想は対前期比で減益の見通し
- 一方で、2024年3月期下半期以降、EV、IoTやDX、AIの推進など半導体需要は回復していてものと予想し、中期経営計画3年目の目標値は達成見込み

(百万円)	2023年3月期 実績	売上高 比率	2024年3月期 通期予想	売上高 比率	対前連結 会計年度 増減率	中期経営計画 2024年3月期 目標値
売上高	61,602	-	63,200	-	2.6%	66,800
営業利益	3,777	6.1%	2,970	4.7%	△21.4%	-
経常利益	3,988	6.5%	3,180	5.0%	△20.3%	4,500
棚卸資産影響額 (△は損)	<mark>505</mark>	-	0	-	-	-
経常利益 (棚卸資産・為替 影響を除く)	<mark>3,463</mark>	5.6%	3,180	5.0%	<mark>△</mark> 8.2%	-
親会社に帰属する 当期純利益	2,737	4.4%	2,150	3.4%	△21.5%	-

中期経営計 2025年3月 目標値	
	71,800
	-
	5,400
	-
	-
	-

^{※2024}年3月期通期予想は、第1四半期連結累計期間までの棚卸資産影響額を見込んでおります。

^{※2024}年3月期通期予想は、第1四半期連結累計期間までの棚卸資産影響額を見込んでおります。

中期経営計画1年目(2023年3月期)業績の振り返り

- 主力の半導体製造装置業界の停滞や、第4四半期にWCAS社持分取得に伴う一時費用126百万円の計上により、中期経営計画1年目は全項目で未達成
- 一方で、売上高は、販売単価上昇を要因とし、過去最高額を更新

		2023年	3月期			
(百万円)	実績値	売上高 比率	中期経営計画 目標値	売上高 比率	差異	達成率
売上高	61,602	-	62,100	-	△497	99.2%
営業利益	3,777	6.1%	3,970	6.4%	△192	95.1%
経常利益	3,988	6.5%	4,080	6.6%	△91	97.8%
棚卸資産影響額 (△は損)	499	-	118	-	381	-
経常利益 (棚卸資産・ 為替影響を除く)	3,489	5.7%	3,962	6.4%	△472	88.1%
親会社に帰属する 当期純利益	2,737	4.4%	2,860	4.6%	△122	95.7%

【訂正後】

中期経営計画1年目(2023年3月期)業績の振り返り

- 主力の半導体製造装置業界の停滞や、第4四半期にWCAS社持分取得に伴う一時費用126百万円の計上により、中期経営計画1年目は全項目で未達成
- 一方で、売上高は、販売単価上昇を要因とし、過去最高額を更新

		2023年				
(百万円)	実績値	売上高 比率	中期経営計画 目標値	売上高 比率	差異	達成率
売上高	61,602	-	62,100	-	△497	99.2%
営業利益	3,777	6.1%	3,970	6.4%	△192	95.1%
経常利益	3,988	6.5%	4,080	6.6%	△91	97.8%
棚卸資産影響額 (△は損)	<mark>505</mark>	-	118	-	<mark>387</mark>	-
経常利益 (棚卸資産・ 為替影響を除く)	<mark>3,463</mark>	<mark>5.6%</mark>	3,962	6.4%	<mark>△</mark> 498	<mark>87.4%</mark>
親会社に帰属する 当期純利益	2,737	4.4%	2,860	4.6%	△122	95.7%